

# Сухой пленочный фоторезист AQUA MER MA320

## Технические характеристики

Применение: Печать и травление, металлизация, тентинг и травление

### СОДЕРЖАНИЕ

1. Условия тестирования
2. Разрешение и адгезия
3. Тентинг
4. Снятие фоторезиста
5. Другое

## 1. Условия тестирования

### Предварительная обработка

Рекомендуемые параметры:

Очистка : 0.5-1.0 мкм

Микротравление : 0.5-1.0 мкм

Параметры тестирования:

Микротравление : 0.89 мкм

### Ламинирование

Рекомендуемые параметры:

Температура: 90-120°C

Давление: 3-5 кг/см<sup>2</sup>

Скорость: 1.0-3.0 м/мин

Параметры тестирования:

Температура: 110°C

Давление: 5.0 кг/см<sup>2</sup>

Скорость: 1.2 м/мин

### Экспонирование

Рекомендуемые параметры:

Источник экспонирования: устройство TZTEC LDI

E=50~95 мДж/см<sup>2</sup>

Примечание: Тестовый данные получены на устройстве экспонирования TZDI-6

Параметры тестирования:

E=50 мДж/см<sup>2</sup>, 6/21sst

E=70 мДж/см<sup>2</sup>, 7/21sst

E=95 мДж/см<sup>2</sup>, 8/21sst

### Проявка

Рекомендуемые параметры:

Температура: 28-32°C

Давление: 1.2-2.0 кг/см<sup>2</sup>

Время: 83-100 сек

В.Р: 40-60%

Параметры тестирования:

Температура: 28°C

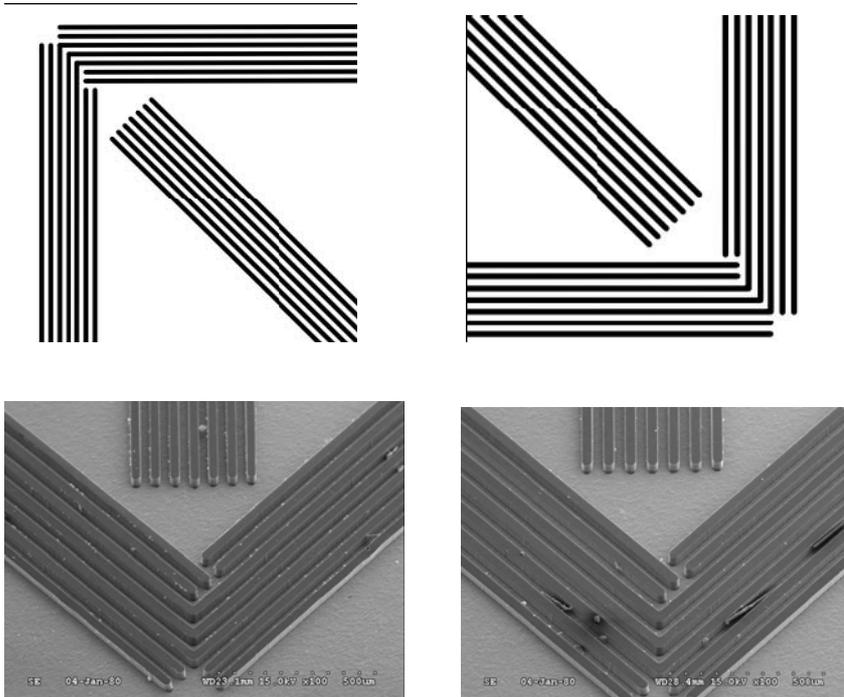
Давление: 1.5 кг/см<sup>2</sup>

Время: 91 сек

В.Р: 50%

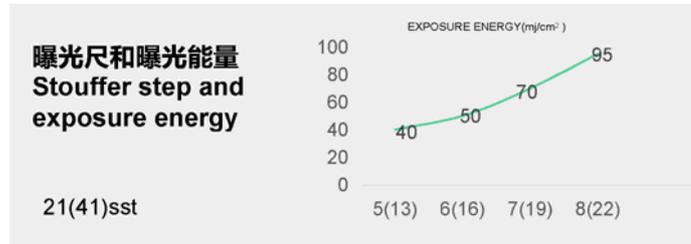
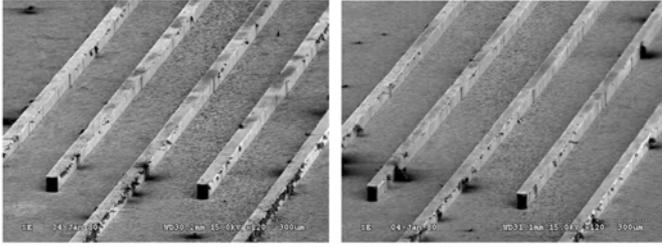
## 2. Разрешение и адгезия

### Разрешение



### Адгезия





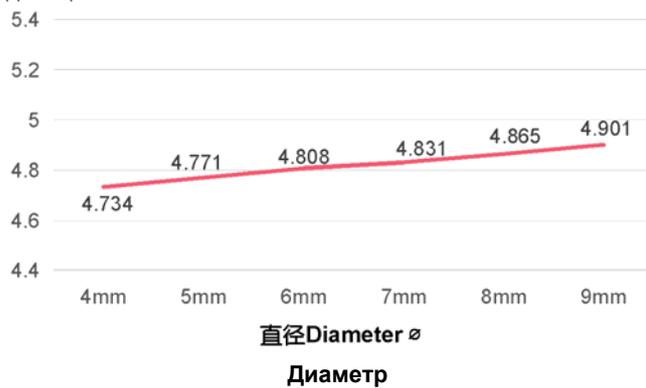
### 3. ТЕНТИНГ

#### Методы тестирования способности к тентингу

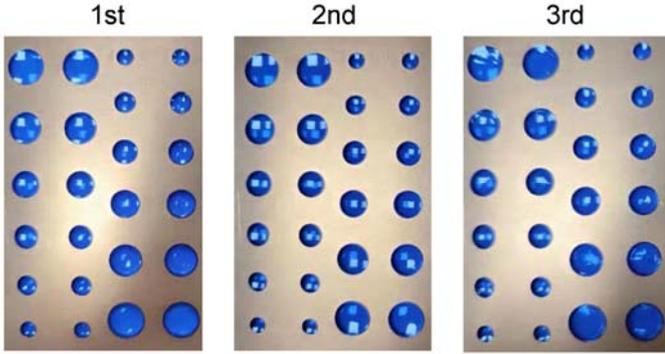
- Метод многократной проявки:
- Детальное описание:
- Повторная проявка в течение трех раз
- Гильзовый тестовый метод:
- Детальное описание:
- Приложение усилия на гильзу-наперсток диаметром 2 мм, чтобы (нарушить) прорвать пленку (фоторезист)

Гильзовый тестовый метод

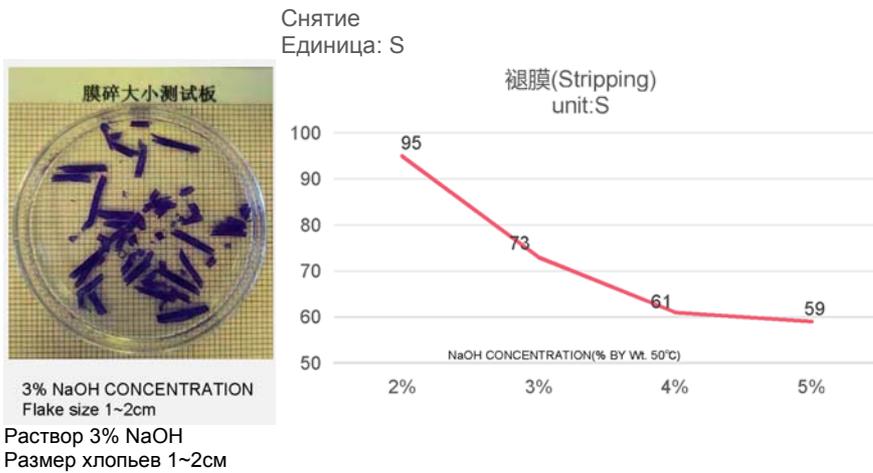
Единица: N



Повторная проявка в течение трех раз



#### 4. Снятие фоторезиста



#### Метод тестирования снятия фоторезиста и его условия

Снятие отмачиванием

Температура: 50°C,

Концентрация раствора NaOH 2%、3%、4%、5% .

#### Результаты снятия

浓度 c	2%	3%	4%	5%
时间 t	95 s	73 s	61 s	59 s

C	2%	3%	4%	5%
t	95 s	73 s	61 s	59 s

#### 5. Другое

##### 01. Замечание по окончательному применению:

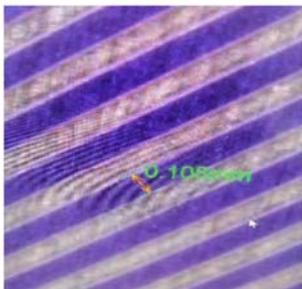
Отсутствие подслоя в кислой меди, диаметр 100 мкм, хорошее отверстие CFM.



## 02. Пример использования

Области применения продукта и реальные изображения:

После проявки при разрешении  $L/S = 100/100$  мкм линии на рисунке - четкие и резкие.



## 03. Преимущества продукта

- Высокое разрешение и высокая адгезия
- Отличная способность к тентированию
- Прямые боковые стенки
- Подходит как для обычных стандартных УФ-систем экспонирования (через шаблон), так и для систем прямого лазерного экспонирования фоторезиста (LDI)

## 04. Рекомендации по условиям упаковки и хранения:

### ХРАНЕНИЕ

Температура: 5-21°C

Относительная влажность 30 - 70%